

2024年7月26日

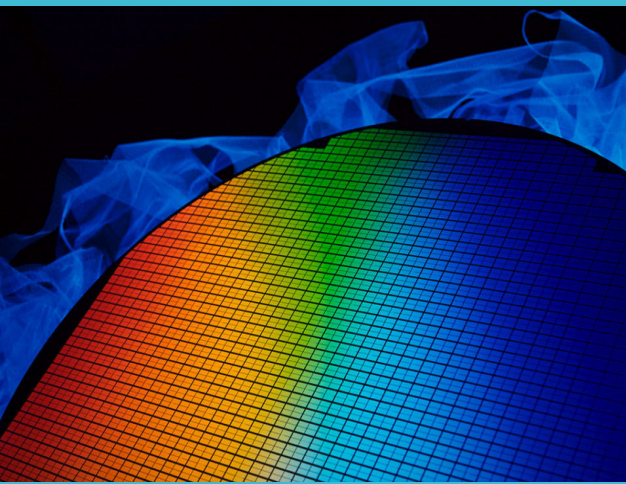
会場：TKP ガーデンシティPREMIUM 横浜駅新高島

第2回3DHIアライアンス公開研究会

<u>12:45~12:50</u>	「オープニング」	3DHI理事長	齊藤 丈靖
<u>12:50~13:20</u>	「アルバックの先端実装向けプラズマ加工技術と成膜技術の紹介」	株式会社アルバック	久保 純也様
<u>13:20~13:50</u>	「ウェットプロセスへの機能性水適用について」	栗田工業株式会社	顔 暢子様
<u>13:50~14:20</u>	「Advanced Packaging用硫酸銅めっきおよびシード層エッチング技術」	株式会社JCU	相澤 涼様
<u>14:20~14:50</u>	「半導体パッケージ向け機能性素材のご紹介」	三菱ケミカル株式会社	西田 怜様
<u>14:50~15:20</u>	休憩 及び 商談・展示会場見学		
<u>15:20~15:50</u>	「半導体製造プロセスにおけるウェーハ表面の評価技術のご紹介」	大塚電子株式会社	加藤 丈滋様
<u>15:50~16:20</u>	「先端半導体パッケージに対する三菱マテリアルの技術紹介」	三菱マテリアル株式会社	片瀬 琢磨様
<u>16:20~16:50</u>	「次世代半導体製造における粘接着技術・後工程装置のご紹介」	リンテック株式会社	前田 淳様
<u>16:50~17:20</u>	「チップレット設計環境の低コスト化」	株式会社ロジック・リサーチ	土屋 忠明様
<u>17:20~17:50</u>	「次世代パッケージに向けたフォトレジストと感光性絶縁膜の展開」	東京応化工業株式会社	黒岩 靖司様
<u>17:50~17:55</u>	「クロージング」	3DHI代表	井上 史大



第2回公開研究会



3DHIアライアンス: <https://3dhi.ynu.ac.jp/>